

2022年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2022) セッションプログラム

【第1日目:8月29日(月)】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:20						
9:40						
10:00	X. 表面改質技術(1)	D. 研削現象の基礎とモニタリング(1)	G. マイクロ・ナノ加工(1)	N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(1)	E. ナノ精密・ELID加工	パネル・カタログ展示
10:20						
10:40						
11:00						
11:20	X. 表面改質技術(2)	D. 研削現象の基礎とモニタリング(2)	G. マイクロ・ナノ加工(2)	N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(2)	L. 切断・割断加工	パネル・カタログ展示
11:40						
12:00						
12:20						
12:40						
13:00						
13:20	X. 表面改質技術(3)	D. 研削現象の基礎とモニタリング(3)	R. 光・ビームによる加工技術(1)	N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(3)	S. 医歯工学	パネル・カタログ展示
13:40						
14:00						
14:20						
14:40			R. 光・ビームによる加工技術(2)	W. 先端半導体材料の精密加工	M. 高性能切削工具の開発と応用	パネル・カタログ展示
15:00						
15:20	T. 付加加工					
15:40						
16:00						
16:20	学会活性化フォーラム (みなとみらいキャンパス 4F 米田吉盛記念講堂)					

【第2日目:8月30日(火)】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:20						
9:40						
10:00	特別講演 (みなとみらいキャンパス 1F 米田吉盛記念ホール)					パネル・カタログ展示
10:20						
10:40						
11:00						
11:20	A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(1)	B. 先端加工計測技術(1)	J. 環境調和型加工技術(1)	K. 難削材・新素材の加工と応用	U. 部品機能と表面性状・形状の評価	パネル・カタログ展示
11:40						
12:00						
12:20						
12:40						
13:00						
13:20	A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(2)	B. 先端加工計測技術(2)	J. 環境調和型加工技術(2)	H. 先進切削加工技術	Q. 磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術	パネル・カタログ展示
13:40						
14:00						
14:20						
14:40						
15:00						
15:15	我が社の新技術発表会 (講演室A~E)					
16:15						
16:30	活動報告会 贈賞式 (みなとみらいキャンパス 1F 米田吉盛記念ホール)					
17:30						
18:30	懇親会 (ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル)					
21:00						

【第3日目:8月31日(水)】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:20						
9:40						
10:00	C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(1)	V. トライボロジー(1)	F. プラスト・バレル加工の最前線(1)			パネル・カタログ展示
10:20						
10:40						
11:00	C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(2)	V. トライボロジー(2)	F. プラスト・バレル加工の最前線(2)	P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術(1)	O. 加工のデータサイエンス(1)	パネル・カタログ展示
11:20						
11:40						
12:00						
12:20						
12:40						
13:00	奨励賞受賞記念講演 (みなとみらいキャンパス 4F 米田吉盛記念講堂)					
13:20						
13:40						
14:00	C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(3)	V. トライボロジー(3)	I. 超音波・振動援用加工	P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術(2)	O. 加工のデータサイエンス(2)	パネル・カタログ展示
14:20						
14:40						
15:00						
15:20						
15:40						
16:00						

2022年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2022) セッションプログラム

【第1日目:8月29日(月)】(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:40	<p><b>【X. 表面改質技術(1)】</b> (水谷正義, 鈴木庸久, 原田泰典, 中村守正) 座長:水谷正義</p>	<p><b>【D. 研削現象の基礎とモニタリング(1)】</b> (大橋一仁, 藤本正和, 吉原信人, 大西孝, 佐藤隆之介) 座長:大橋一仁</p>	<p><b>【G. マイクロ・ナノ加工(1)】</b> (松井伸介, 松村隆, 江頭快, 天本祥文) 座長:松井伸介</p>	<p><b>【N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(1)】</b> (吉岡勇人, 金子順一, 三浦弘幸, 猪狩龍樹, 齋藤明德) 座長:金子順一</p>	<p><b>【E. ナノ精密・ELID加工】</b> (伊藤伸英, 片平和俊, 江面篤志) 座長:江面篤志</p>	9:40
10:00	<p>A01 連続波レーザーを用いたレーザー誘起ブレーティングによるニッケル析出物と温度分布の関係 ○上野翔太郎, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由, 合谷賢治, 伊藤亮(秋田県立大学), 村岡潤一(山形県工業技術センター)</p>	<p>B01 クリープフィード研削におけるSG砥石作業面の3Dマイクロトポグラフィ ○藤本正和, 藤田雅史(近畿大学)</p>	<p>C01 超硬合金製マイクロディンプルアレイ金型の超精密研削加工 ○仙波卓弥, 天本祥文(福岡工業大学), 角谷均(住友電気工業)</p>	<p>D01 マシニングセンタにおけるCAM システムによる工具経路生成の精度比較 勝間田侑輝, 横田川柊, ○齋藤明德(日本大学), 小野裕道, 安齋弘樹, 松本聖可(福島県ハイテクプラザ)</p>	<p>E01 PELIDを用いた化学反応援用型複合砥粒ファイバーボンド砥石の製作 ○伊藤颯希, 伊藤伸英(茨城大学), 大森整(理化学研究所), 稲澤勝史(栃木県)</p>	10:00
10:20	<p>A02 ショットピーニングによるマグネシウム合金への非金属材料の接合 杉原健太, 中嶋優作, ○原田泰典, 田中一平(兵庫県立大学)</p>	<p>B02 正二十面体砥粒モデルを用いた作用砥粒数の基礎的検討 ○鈴木優太, 楠山純平, 中尾陽一(神奈川大学)</p>	<p>C02 ダイヤモンド研削工具による超硬合金の微細穴あけ加工 ○橋田桂一, 宮武典万, 江頭快(京都工芸繊維大学)</p>	<p>D02 3DCADを用いた工作機械の直接制御 ○横関大佐, 林晃生, 河村夏風, 森本喜隆(金沢工業大学)</p>	<p>E02 光造形方式3Dプリンタとファインパブル生成装置を援用した砥石製作システムの開発 ○吉田凜太郎, 高畑光汰, 伊藤伸英(茨城大学), 稲澤勝史(栃木県), 大森整(理化学研究所)</p>	10:20
10:40	<p>A03 ショットピーニングを用いた軽金属への異種金属接合 ○杉原健太, 原田泰典(兵庫県立大学)</p>	<p>B03 平面研削加工の研削反りのモデリングとシミュレーション ○市原浩一(住友重機械工業)</p>	<p>C03 単純円柱形マイクロ工具による切削・研削複合微細軸加工の加工特性 ○福山敦也, 岡野飛南太, 江頭快(京都工芸繊維大学)</p>	<p>D03 曲面加工における工具経路の評価と高精度加工のための補正 ○松本大樹, 青山英樹(慶應義塾大学)</p>	<p><b>【L. 切断・割断加工】</b> (諏訪部仁, 松坂壮太, 浅井義之, 坂本智) 座長:松坂壮太, 坂本智</p>	10:40
11:00	<p><b>【X. 表面改質技術(2)】</b> 座長:中村守正</p>	<p><b>【D. 研削現象の基礎とモニタリング(2)】</b> 座長:大西孝</p>	<p><b>【G. マイクロ・ナノ加工(2)】</b> 座長:江頭快</p>	<p><b>【N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(2)】</b> 座長:齋藤明德</p>	<p>E04 マルチワイヤソーによる延性モード加工の高精度化に関する研究 ○田中晃太郎, 諏訪部仁, 石川憲一(金沢工業大学), 加藤智久(産業技術総合研究所)</p>	11:00
11:20	<p>A05 落錘試験およびショットピーニング試験によるPVD膜の耐衝撃性評価 ○後裕介(ウメク), 原田泰典, 田中一平(兵庫県立大学), 荻巣高志(ウメク)</p>	<p>B05 ティーパーニングを用いた機上計測による砥石作業面の解析(第3報) ○植木優輔, 松本竜宙, 樋口開斗, 川下智幸, 坂口彰浩, 松尾修二(佐世保工業高専)</p>	<p>C05 AFMスクラッチによる研磨加工特性の評価 ○磯野泰地, 松井伸介, 鳥居典博(千葉工業大学)</p>	<p>D05 長尺内面研削スピンドルの開発に関する研究 ○安達和彦(中部大学), 大久保信雄, 大久保元博(大久保精工), 向井良平(三井精機工業), 高橋宏美(豊幸)</p>	<p>E05 ダイヤモンド電着ワイヤ工具による溝加工時の加工温度に関する基礎的研究 ○戴嘉麗, 福山隼太, 坂本智(横浜国立大学), 近藤康雄(山形大学), 山口顕司(米子工業高専)</p>	11:20
11:40	<p>A06 Cu,Snを含有する高硬度微粒子投射材を用いたショットピーニングによる表面改質 ○澤田俊之(山陽特殊製鋼)</p>	<p>B06 研削振動の高周波特性に関する検討 ○盧金坤, 田中秀明(湘南工科大学)</p>	<p>C06 傾斜イオンミリングによるナノワイヤのバリ除去加工 ○本山弘之, 菅洋志(千葉工業大学), 島久, 秋永広幸, 内藤泰久(産業技術総合研究所)</p>	<p>D06 工作機械主軸ヘッドの熱変位抑制方法 ○高澤重依, 崔成日, 藤井崇, 上之原康弘, 向井良平(三井精機工業)</p>	<p>E06 スクライブによる残留応力場での亀裂伝播の方向性 ○村上久美子, 曾山浩, 池内亮輔, 北市充, 川畑孝志(三星ダイヤモンド工業)</p>	11:40
12:00	<p>A07 ショットピーニングと熱処理を利用したβ型Ti合金の表面特性の向上 ○青木俊憲(兵庫県立工業技術センター), 原田泰典(兵庫県立大学)</p>	<p>B07 深層学習を用いたダイヤモンドワイヤ表面の機上計測 ○末永柊輝, 澤田燎佑, 中村麟太郎, 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二(佐世保工業高専)</p>	<p>C07 マイクロボールフォーミングによる骨芽細胞成長性の改善 ○佐藤嵩一郎, 山口桂司, 長谷川夏樹, FrancescoBoschetto, EriaMarin, GiuseppePezzotti, 太田稔(京都工芸繊維大学)</p>	<p>D07 高速小径空気静圧スピンドル用軸心水冷構造の設計と効果 ○脇谷趣聞, 楠山純平(神奈川大学), DmytroFedoryenko(東北大学), 中尾陽一(神奈川大学)</p>	<p>E07 ホイール割断における加工時の刃先直下の応力解析 ○石鍋葵(千葉大学), 今井健太郎(群馬大学), 伊東翔, 松坂壮太, 比田井洋史(千葉大学)</p>	12:00
12:20	***** 休憩 *****					12:20

12:40	***** 休憩 *****				12:40	
13:00	<b>【X. 表面改質技術(3)】</b> 座長:鈴木庸久	<b>【D. 研削現象の基礎とモニタリング(3)】</b> 座長:藤本正和	<b>【R. 光・ビームによる加工技術(1)】</b> (比田井洋史, 細野高史, 池野順一, 江面篤志) 座長:江面篤志	<b>【N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM(3)】</b> 座長:猪狩龍樹	<b>【S. 医歯工学】</b> (佐藤秀明, 水谷正義, 亀山雄高) 座長:水谷正義 E10 ナノゲル工学を基盤技術とした免疫療法および再生医療の開発 ○足立哲也(京都府立医科大学), 田原義朗(同志社大学), 宮本奈生, 新屋政春, 山本俊郎(京都府立医科大学), Giuseppe Pezzotti(京都工芸繊維大学), 秋吉一成(京都大学), 松田修, 金村成智(京都府立医科大学)	13:00
13:20	A11 窒素ドーパドDLC膜の膜構造と力学特性の関係 ○人見元規, 中村守正, 松岡敬(同志社大学)	B11 メカノケミカル砥石を利用した単結晶シリコンの超仕上げ(第4報) ○池田真遥, 古城直道, 山口智実, 廣岡大祐(関西大学), 角田勝俊, 棚田憲一(ミスホ)	C11 結晶化ガラスのレーザスライジング ○三浦祐介, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学)	D11 びびり振動回避を目的とした工作機械の剛性制御に関する研究 ○柴田興利, 林晃生, 森本喜隆(金沢工業大学)	E11 金属アレルギー患者に対する新規インプラント材料の創製 ○小正聡(大阪歯科大学)	13:20
13:40	A12 表面波プラズマを用いた窒化炭素の作製 ○大平将寛, 田中一平, 原田泰典(兵庫県立大学)	B12 ドレッシング表面の定量化と研削特性との関係 ○山口潤人, 内田元, 山田高三(日本大学)	C12 ビコ秒パルスレーザを使った超硬合金に対する精密・微細加工技術 ○天本祥文, 仙波卓弥, 三浦大久真(福岡工業大学)	D12 直動ガイドにおける転動体の挙動 ○大関浩, 池田洗司, 市原裕斗(千葉工業大学)	E12 アルミナ微粒子ピーニングを施したチタンの細胞接着性に及ぼす影響 ○大形瑠, 桃沢愛, 鹿内颯太, 亀山雄高, 高橋玄宇(東京都市大学)	13:40
14:00	A13 DLC膜の力学的特性に対する基板へのイオンエッチング処理効果 ○鯛涼太, 中村守正, 松岡敬(同志社大学)	B13 偏光カメラによる研削ベルト作業面上の砥粒状態の評価 ○大平洗, 小日向宏天, 孕石泰丈, 清水毅(山梨大学)	C13 レーザ溶断によるフレキシブルガラスの溶融切断端面形成の試み ○長野野人, 伊東翔, 比田井洋史, 松坂壮太(千葉大学)	<b>【W. 先端半導体材料の精密加工】</b> (黒河周平, 加藤智久, 河田研治) 座長:黒河周平	E13 研磨液を含浸させたビトリファイドボンド軸付き砥石による歯科用純チタンの研磨に関する研究 ○富川駿, 佐藤秀明, 亀山雄高, 眞保良吉(東京都市大学), 小正聡(大阪歯科大学)	14:00
14:20	A14 高密度プラズマを用いたSiCN膜の作製 ○田中一平, 波多江優輝, 原田泰典(兵庫県立大学)	B14 円筒トラバース研削における工作物の弾性変形を利用したクラウニング形状制御 ○粒田元希, 大西孝, 藤井英毅(岡山大学), 坂倉守昭(大同大学), 大橋一仁(岡山大学)	<b>【R. 光・ビームによる加工技術(2)】</b> 座長:比田井洋史	D14 アルカリ雰囲気におけるSiCのエッチング現象 ○加藤淳暉, 木之下美佐紀, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学)	<b>【M. 高性能切削工具の開発と応用】</b> (村上大介, 坂本竜司郎, 間紀旺) 座長:村上大介	14:20
14:40	<b>【T. 付加加工】</b> (阿部壮志, 山内友貴, 福山遼) 座長:福山遼		C15 カーブロス制御したSiCのレーザスライジング法 ○山田洋平(埼玉大学), 納谷剛志, 岩瀬比宇麻, 中西賢一(中村留精密工業), 池野順一(埼玉大学)	D15 陽極酸化を利用したSiCウエハの高効率電気化学機械研磨(ECMP)法の開発(第2報) ○河田研治, 加藤智久(産業技術総合研究所), 宮下忠一(不二越機械工業)	E15 鉛フリー真鍮の小径穴加工に関する研究 ○成木忠明(金沢工業大学), 鈴木健一(花王), 加藤秀治(金沢工業大学), 片山仁, 岡尚之(三菱マテリアル)	14:40
15:00	A16 フィラー溶出によって得られた多孔質AM部品の空孔率と機械的特性の調査 ○藤井紘一, 山内友貴, 木暮尊志(東京都立産業技術研究センター)		C16 工作機械用板金部品のレーザロボット溶接の治具レスに向けたホゾ組継ぎ手の影響の考察 ○山口陽平(DMG森精機), 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学)	D16 ダイヤモンド砥粒を用いたプラズマ援用研磨による窒化ガリウム基板の高効率研磨 ○陶通, 孫栄硯, 川合健太郎, 有馬健太, 山村和也(大阪大学)	E16 超精密切削加工に使用できる超微粒子超硬合金製のノーズRバイト ○岡崎峰, 仙波卓弥, 天本祥文(福岡工業大学)	15:00
15:20	A17 人工高重力を付与した粉末床溶融結合におけるリコーティング工程の評価 ○小池綾, 金丸聡真(慶應義塾大学)			D17 窒化ガリウムのバフ研磨加工 ○入江創太, 東駿佑, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学), 倉原佑規, 真野稔正(アイオン)	E17 刃先へのレーザ加工を施したcBN工具を用いた鉄系金属のマイクロ溝加工の試み ○北川大地, Meshram Tushar, 間紀旺(慶應義塾大学)	15:20
15:40	A18 ワイヤ+アーク放電を用いたアディティブ・マニファクチャリングによる傾斜角度を有する薄壁形状造形技術開発 ○阿部壮志, 井口玲良, 金子順一(埼玉大学)		***** 休憩 *****	D18 プラズマ援用研磨による多結晶ダイヤモンド基板の高効率ダメージフリー平坦・平滑化に関する研究(第1報) ○杉本健太郎, 孫栄硯, 川合健太郎, 有馬健太, 山村和也(大阪大学)	E18 超音波切削法による硬脆材料の超精密加工の研究 岩井学, ○金戸綾汰, 渡邊龍輝(富山県立大学), 平田傑之(新居浜工業高専), 岳義弘(超音波加工技術研究所), ニノ宮進一(日本工業大学)	15:40
16:00					16:00	
16:20	学会活性化フォーラム (みなとみらいキャンパス 4F 米田吉盛記念講堂) 「研削熱の影響とその抑制」 防衛大学校 名誉教授 奥山繁樹氏				16:20	

2022年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2022)セッションプログラム

【第2日目:8月30日(火)】(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	
10:00	特別講演 (みなとみらいキャンパス 1F 米田吉盛記念ホール) 「宇宙と地球をつなぐ機械技術 ～ものづくりが変える宇宙～」 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA 油井亀美也宇宙飛行士					10:00
11:00	<b>【A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(1)】</b> (林偉民, 鈴木恵友, 佐竹うらら, 村田順二, プカン アントニー) 座長: 林偉民	<b>【B. 先端加工計測技術(1)】</b> (浅川直紀, 水谷康弘, 清水裕樹, 伊東聡) 座長: 伊東聡	<b>【J. 環境調和型加工技術(1)】</b> (岩井学, ニノ宮進一, 西川尚宏, 佐藤運海) 座長: 佐藤運海	<b>【K. 難削材・新素材の加工と応用】</b> (静弘生, 北嶋孝之, 梶原優介) 座長: 静弘生		11:00
11:20	A20 水膜ポーラスチャックの基板保持特性 ○吉富健一郎, 宇根篤暢(防衛大学校)	B20 ロータリー型インフィード研削における In-Process 温度計測装置の開発 ○塩見山太郎, 高橋精樹, 周立波, 小貫哲平, 尾島裕隆, 清水淳, 金子和暉(茨城大学)	C20 ロータリー切削工具の機上再研磨を目的とした導電性PCDによる放電・研削逐次成形 ○松本千里, ニノ宮進一, 山田庸二(日本工業大学), 岩井学(富山県立大学)	D20 硬脆材料のレーザ援用微細切削加工に関する研究 ○小磯翔, 由井明紀(神奈川大学)	<b>【U. 部品機能と表面性状・形状の評価】</b> (吉田一郎, 三浦勝弘, 石井耕一) 座長: 吉田一郎	11:20
11:40	A21 光透過率測定によるCMC Na 添加研磨液における砥粒沈降特性の評価 ○高塚溪太, 瀧野日出雄(千葉工業大学)	B21 AEセンサを用いた無線式切削監視装置の研究 ○植松瑞貴, 加藤和弥, 黒木竜樹(湘南工科大学), 西川顕二(日立製作所)	C21 ウルトラファインパブルクーラントのパブル条件と加工性能の関係 安斎聡(安齊管鉄), ○生駒敦己, 渡邊龍輝, 岩井学(富山県立大学), 大木 伸一郎 (IEST), ニノ宮進一(日本工業大学)	D21 不水溶性切削油剤を用いたCFRPの側面切削加工に関する研究 ○北嶋孝之, 北村友一, 猪狩龍樹(防衛大学校)	E21 摺動面の摩耗の過程を解析できる表面粗さ解析法の開発 ○永井奨, 吉田一郎, 榎原僚, 斎藤亮(法政大学)	11:40
12:00	A22 エッジ・ロールオフを抑制する研磨パッド特性 ○佐竹うらら, 榎本俊之(大阪大学)	B22 砥石表面3次元計測による砥粒判別 ○大野光貴, 尾島裕隆, 周立波, 小貫哲平, 清水淳, 金子和暉(茨城大学)	C22 使用済み水溶性油剤のウルトラファインパブル循環による臭気抑制効果 ○李牧之, ニノ宮進一(日本工業大学), 野村哲雄(ナノデバイス), 岩井学(富山県立大学)	D22 微粒化多結晶純マグネシウムの切削特性 ○大野威徳, 丁禹元, 潘襄豪(帝京大学)	E22 AFチルト法の非球面形状測定への適用 ○三浦勝弘, 遠藤万平, 能勢敦子, 古田島秀夫(三鷹光器)	12:00
12:20	***** 休憩 *****					12:20

	【A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(2)】 座長:村田順二	【B. 先端加工計測技術(2)】 座長:小貫哲平	【J. 環境調和型加工技術(2)】 座長:岩井学	【H. 先進切削加工技術】 (田代徹也, 関根務, 杉原達哉, 林宏和) 座長:田代徹也	【Q. 磁界・電界磁粒制御による次世代加工技術】 (川久保英樹, 鄒艶華, 久住孝幸, 野村光由) 座長:野村光由, 川久保英樹	
13:20	A24 フォトリソグラフィ流体を用いた新しい研磨法の開発 第1報 ○西崎悠樹, BeaucampAnthony(京都大学)	B24 5軸制御マシニングセンタからの加工情報と協働ロボットによる仕上げ作業の統合 ○山本隆将, 松田亮, 新堂正俊(山本金属製作所), 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学)	C24 インラインBrix 計による水溶性加工液の濃度モニタリング ○山口顕司, 高塚穰, 明里望夢(米子工業高専), 近藤 康雄(山形大学), 坂本 智(横浜国立大学)	D24 エンドミル加工時のオンライン情報モニタリングシステムの開発 ○関根務(成蹊大学)	E24 スモールツールによる電子デバイス向け基板の高効率研磨技術の開発 池田洋, ○小野寺宏太(秋田工業高専), 久住孝幸, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)	13:20
13:40	A25 水酸化フラーレンによる炭素生成物を利用した難加工研磨技術に関する研究 鈴木恵友, ○山本颯真, 西澤秀明, 轟木裕太, カチョーンルンルアンパナート(九州工業大学)	B25 ステッチング処理を用いた斜入射干渉計の測定範囲拡大に関する研究 ○伊東聡, 津川楓馬, 有賀正和, 松本公久, 神谷和秀(富山県立大学)	C25 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 電解酸化水を用いた78パーマロイ材の表面改質処理 ○佐藤運海, 川久保英樹(信州大学)	D25 理想的加工法の具現化 ○末吉康嗣, 仙波卓弥, 天本祥文(福岡工業大学), 角谷均(住友電気工業)	E25 スモールツールによる新たな高効率研磨技術の創出 ○土田真子, 池田洋(秋田工業高専), 久住孝幸, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)	13:40
14:00	A26 ダイヤモンドシートを用いた固定砥粒研磨に及ぼす基板初期面性状とクーラントの影響 ○澁谷兼斗, 畝田道雄(金沢工業大学)	B26 Detecting transverse shift in the ellipsometry based on Spin Hall Effect of Light (SHEL) through weak measurement for sub nanometer surface area measurement ○Zahra Naila, 水谷康弘, 上野原努, 高谷裕浩(大阪大学)	C26 電気防錆加工法の研究開発 ○西川尚宏(岩手大学)	D26 旋盤加工の端面切削を利用した切削油剤の評価に関する研究 ○阿部俊哉, 澤武一(芝浦工業大学)	E26 電界スライシング技術におけるスラリー濃度依存性に関する基礎検討 ○細川遥花, 池田洋(秋田工業高専), 久住孝幸, 越後谷正見, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)	14:00
14:20		B27 電流センサを用いた無線式切削力測定装置の研究 ○黒木竜樹, 加藤和弥, 植松瑞貴(湘南工科大学), 西川顕二(日立製作所)		D27 単結晶MgF <sub>2</sub> の楕円振動切削加工における振動振幅条件と臨界切り込み深さの関係 ○松田莞, 柿沼康弘(慶應義塾大学)	E27 電解水併用磁粒レス磁気援用内面加工に関する研究 ○川久保英樹, 佐藤運海(信州大学)	14:20
14:40					E28 磁気混合流体(MCF)研磨における精密仕上げ ○浅間皓貴, 野村光由, 鈴木庸久, 藤井達也(秋田県立大学), 呉勇波(南方科技大学)	14:40
15:00	***** 休憩 *****					15:00
15:15	我が社の新技術発表会 (講演室A~E)					15:15
16:15	***** 休憩 *****					16:15
16:30	活動報告会 贈賞式 (みなとみらいキャンパス 1F 米田吉盛記念ホール)					16:30
17:30	***** 移動 *****					17:30
18:30	懇親会 (ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル)					18:30
21:00						21:00

2022年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2022) セッションプログラム

【第3日目: 8月31日(水)】 (セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:20	<p><b>【C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(1)】</b> (山口桂司, 澤武一, 市田良夫, 松浦寛) 座長: 山口桂司</p>	<p><b>【V. トライボロジー(1)】</b> (清水淳, 宇佐美初彦, 酒井康徳) 座長: 清水淳</p>	<p><b>【F. プラスト・パレル加工の最前線(1)】</b> (嶋田慶太, 南部紘一郎, 宮島敏郎) 座長: 嶋田慶太</p>			9:20
9:40	A29 熱可塑性樹脂砥石を用いた金属の研削 ○齋裕大, 井上慶星, 伊澤空哉, 南條健人, 松浦寛(東北学院大学)	B29 電気ニッケルめっき浴から微粒子ピーニング処理アルミニウム表面に無電解的に析出した皮膜の摩耗挙動 ○宮川拓也, 中原寛生, 亀山雄高, 佐藤秀明, 眞保良吉(東京都市大学)	C29 マイクロ・スラリー・ジェット・エロージョン(MSE)法による金型用硬質薄膜の熱劣化評価 ○宮島敏郎(富山県立大学)			9:40
10:00	A30 集中度別の不織布砥石による研削性能の比較 ○井上慶星, 齋裕大, 伊澤空哉, 南條健人, 松浦寛(東北学院大学), 相澤崇史(産業技術総合研究所東北センター)	B30 噴射加工により改質された金属表面のトライボロジー ○宇佐美初彦(名城大学)	C30 ジャイロパレル研磨を活用した金属AM造形物のサポート除去 ○山谷晃平, 橋本洋平, 古本達明, 阿部諭, 山口貢, 小谷野智広(金沢大学), 江面篤志(三条市立大学)			10:00
10:20	A31 ボンド剤に不織布を用いた砥石の開発 ○鈴建僚祐, 齋裕大, 井上慶星, 南條健人, 松浦寛(東北学院大学), 相澤崇史(産業技術総合研究所東北センター)	B31 微粒子ピーニング処理における粒子法を用いた粒子速度解析 ○南部紘一郎(大阪産業大学), 佐伯友輔, 奥宮正洋(豊田工業大学)	C31 加工物軸方向の研磨速度の偏りを解消できる新型ドラッグフィニッシュ装置 ○久綱敦也, 橋本洋平, 古本達明, 山口貢, 小谷野智広(金沢大学), 江面篤志(三条市立大学), 河原達樹, 関谷章仁(テックトン), 細川晃(公立小松大学)	<p><b>【P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術(1)】</b> (森田晋也, 鈴木浩文, 山村和也, 古城直道, 古木辰也, 福田将彦) 座長: 森田晋也</p>	<p><b>【O. 加工のデータサイエンス(1)】</b> (児玉紘幸, 廣垣俊樹, 周立波, 坂口彰浩) 座長: 小貫哲平</p>	10:20
10:40	<p><b>【C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(2)】</b> 座長: 松浦寛</p>	<p><b>【V. トライボロジー(2)】</b> 座長: 酒井康徳</p>	<p><b>【F. プラスト・パレル加工の最前線(2)】</b> 座長: 宮島敏郎</p>	D32 X線ミラーの超精密切削 ○樋口峻, 鈴木浩文, 古木辰也, 三浦勝弘(中部大学), 粟木久光(愛媛大学), 森田晋也(東京電機大学), 中川恒裕(ナクロ)	E32 畳み込みオートエンコーダの異常検知機能を用いたエンドミル摩耗判定システムの開発 ○西隆宏, 児玉紘幸, 大橋一仁(岡山大学)	10:40
11:00	A33 溶媒キャスト法による高濃度カーボンナノチューブ複合フェノールレジンボンド砥石の成形条件の検討 ○立木良芽, 佐々木宇宙, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由, 伊藤亮(秋田県立大学)	B33 砥粒表面におけるトライボロジー現象変化のデュアルAEセンシング ○長谷亜蘭(埼玉工業大学)	C33 霜発生を抑制可能なショットプラスト技術の構築 ○池田智, 南部紘一郎(大阪産業大学)	D33 PCD工具によるCVD-SiCの超精密切削 ○坂井田未来, 鈴木浩文, 古木辰也, 三浦勝弘(中部大学), 伊藤洋介, 藤井一二(日進工具)福田達也(東海エンジニアリングサービス)	E33 ランダムフォレスト手法に援用された切削条件導出の有用性に関する基礎的研究 ○盛元達雄, 喜多大輔, 児玉紘幸, 大橋一仁(岡山大学)	11:00
11:20	A34 高濃度カーボンナノチューブ複合ポリイミドレジンボンドの熱伝導率および高温耐摩耗性 ○松本拓真, 佐々木正太, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由(秋田県立大学), 泉妻孝迪, 大津加 慎教(山形県工業技術センター)	B34 シリコンCMPの分子動力学シミュレーション ○金子和暉, 橋村紀香, 清水淳, 周立波, 小貫哲平, 尾崎裕隆(茨城大学)	C34 銅合金の疲労強度に及ぼす軟質ピーニング処理の影響 ○國松龍武, 南部紘一郎(大阪産業大学)	D34 無電解Ni-Pめっきにおけるめっき浴温度が表面粗さに与える影響 ○中川恒裕(ナクロ), 鈴木浩文(中部大学)	E34 エンドミル加工面模様による高い振動数のびり振動の逆解析と無線工具ホルダを用いた検証 ○尾崎信利, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学), 松田亮(山本金属製作所)	11:20
11:40	A35 切断・溝加工用電着金網砥石の開発 ○倉茂周治, 野村衛, 伊藤幸男, 福原義也, 笹原弘之(東京農工大学)	B35 微小振動援用切削でテクスチャ加工した圧痕状パターン の周期的配置による金属表面の乾式すべり特性 ○清水淳, 山本武幸, 金子和暉, 周立波, 小貫哲平, 尾崎裕隆(茨城大学)	C35 高強度アルミニウム合金のショットピーニング後の残留応力緩和と疲労強度評価 ○斎藤悠太, 小林祐次(新東工業), 中村裕紀, 渡邊 裕貴(豊田工業高専)	D35 超音波振動援用インデンテーションによるテクスチャリング 鈴木浩文, ○後藤晃, 古木辰也, 三浦勝弘(中部大学), 由井明紀(神奈川大学), 中川恒裕(ナクロ), 牧野俊清, 上原純一(長津製作所), 森泉利之(城南ダイヤモンド工業)		11:40
12:00						12:00
12:20						12:20
12:40						12:40

\*\*\*\*\* 休憩 \*\*\*\*\*

13:00	奨励賞受賞記念講演 (みなとみらいキャンパス 4F 米田吉盛記念講堂)				13:00	
13:20					13:20	
13:40	<b>【C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(3)】</b> 座長:澤武一, 山口桂司	<b>【V. トライボロジー(3)】</b> 座長:宇佐美初彦	<b>【I. 超音波・振動援用加工】</b> (神雅彦, 水谷秀行, 今井健一郎, 磯部浩己, 原圭祐) 座長:神雅彦	<b>【P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術(2)】</b> 座長:鈴木浩文	<b>【O. 加工のデータサイエンス(2)】</b> 座長:児玉紘幸	13:40
14:00	A41 レーザを用いてダイヤモンド砥粒を固着したミーリング工具の開発 ○高山洸輔, 諏訪部仁, 石川憲一(金沢工業大学)	B41 超音波援用塑性加工による大面積及び曲面への微細凹凸創成 ○小関雅大, 酒井康徳(芝浦工業大学)	C41 ワーク励振による超音波援用小径ドリル加工に関する研究 ○辻尚史(長岡技術科学大学, 秋田工業高専), 高島孝太(長岡技術科学大学), 櫻田陽(秋田工業高専), 原圭祐(長岡技術科学大学), 宮脇和人(秋田工業高専), 磯部浩己(長岡技術科学大学)	D41 CVD-SiC製円柱製造のためのPCD製くり抜き工具の開発 ○熊谷大樹(岐阜大学), 古木辰也, 鈴木浩文(中部大学), 藤井一二, 伊藤洋介(日進工具), 福田達也, 伏見雅人, 伊藤公一(東海エンジニアリングサービス), 上坂裕之(岐阜大学)	E41 顕微Raman断層イメージング計測における測定データ品質指標の検討 ○小貫哲平, 黒田隼乃介, 劉燦, 柴教一郎, 金子和暉, 尾高裕隆, 清水淳, 周立波(茨城大学)	14:00
14:20	A42 工具-工作物間速度インプロセス可変研削法の研究 ○磯駿太郎, 柳原聖, 篠崎烈(有明工業高専)	B42 アルミニウム及び銅のマイクロ摩擦攪拌接合に及ぼす接合パラメータの影響 ○安藤優, 酒井康徳(芝浦工業大学)	C42 超音波振動援用切削時に創成される表面テクスチャの配列制御システムの開発 ○高島孝太(長岡技術科学大学), 櫻田陽(秋田工業高専), 原圭祐(長岡技術科学大学), 柳沢憲史(長野工業高専), 辻尚史(秋田工業高専), 磯部浩己(長岡技術科学大学)	D42 金属製細胞培養器開発に資する極小径PCDエンドミルによるCo-Cr合金の微細溝加工 ○今川翔太, 森田晋也(東京電機大学), 片平和俊(理化学研究所), 吉川直希(慶應義塾大学), 今城哉裕(東京女子医科大学), 小茂鳥潤(慶應義塾大学)	E42 AI技術を用いた切削工具摩耗の異常検知 ○村越智弘, 周立波, 小貫哲平, 尾高裕隆, 清水淳, 金子和暉(茨城大学)	14:20
14:40	A43 高出力レーザー援用研削加工の有効性に関する研究 ○櫻井風花, 松浦寛(東北学院大学)	B43 銅合金の摩擦・摩耗特性に及ぼす製造法の影響 ○石川諒真, 宮島敏郎(富山県立大学), 野村公人, 北山進, 藤丸陽一(中越合金鑄工)	C43 背分力振動援用延性モード切削加工における工具コーナ半径の影響 ○今井健一郎, 小山内裕太(神奈川工科大学)	D43 橋脚振動切削によるガラス材光学部品の加工検討 ○長坂圭祐, 福田将彦(芝浦機械), 浜田晴司	E43 生産分野におけるAI異常検知システムの開発 ○石川翔梧, 小松敏大, 村越智弘, 周立波, 尾高裕隆, 小貫哲平, 清水淳, 金子和暉(茨城大学)	14:40
15:00	A44 LN結晶の自由曲面加工装置の試作 ○櫻田陸人, 銚建僚祐, 松浦寛(東北学院大学)		C44 小径内面ホーニング過程に及ぼすクロスハッチ角の影響 ○西垣一弘(中部大学), 水野義則(日進製作所), 澤田伶, 棚橋勇之, 水谷秀行(中部大学)	D44 光学ガラスの表面下損傷の可視化(第4報) ○北村駿弥, 遠藤大暉, 古城直道, 廣岡大祐, 山口智実(関西大学), 角田勝俊, 棚田憲一(ミズホ)	E44 機械学習を用いたエンドミル加工のびびり振動判定 ○横田知宏, 奥田誠(神奈川県立産業技術総合研究所)	15:00
15:20	A45 廃炉を目的とする「砥石搭載を想定した全機械駆動ロボットアーム」の開発及び性能評価 ○高橋悠, 千賀颯斗, 松浦寛(東北学院大学)		C45 超音波振動研磨法に関する基礎的研究 第2報: 整粒したcBN電着砥石による研磨特性 神雅彦(日本工業大学), ○金井秀生(カナリエンジニアリング)			